

**KLEBEN +  
DICHTEN +  
VERGIESSEN**

**Kisling**



# 8702

**Die leistungsstarke einkomponentige, nicht-vernetzende Wärmeleitpaste für anspruchsvolle Leistungselektronik.**

Unsere innovative Füllstoffmatrix stellt die ideale Grundlage für anspruchsvolle Wärmeleitpasten und polyurethanbasierende GapFiller dar. Diese zeichnen sich durch hohe Wärmeleitfähigkeiten bei gleichzeitig hervorragenden Verarbeitungseigenschaften aus und optimieren somit das Thermomanagement signifikant. Ebenso bieten sie eine hohe elektrische Isolierung und verzichten hierbei komplett auf Silikone sowie Lösungsmittel.

Bei 8702 handelt es sich um eine leistungsstarke einkomponentige, nicht-vernetzende Wärmeleitpaste. Die Paste sticht durch ihre hohe Wärmeleitfähigkeit von  $2\text{W/mK}$  sowie durch ihre Langzeitstabilität im Einsatz hervor. Insbesondere in der Leistungselektronik, wo eine hohe Wärmeabfuhr bzw. Bauteilkühlung gefordert ist, kann die Paste ausgezeichnet eingesetzt werden.

# 8702

- + 1K Wärmeleitpaste
- + Thixotrop
- + Nicht austrocknend
- + Wärmeleitfähigkeit 2,0W/mK
- + Silikonfrei



## Eigenschaften

<b>Produktkategorie</b>	Vergussmassen   Wärmeleitpaste
<b>Chemische Basis</b>	1K Paste
<b>Farbe</b>	Natur (Creme)
<b>Dichte [g/cm<sup>3</sup>]</b>	2.20 – 2.50
<b>Viskosität [mPas]</b>	150 000 – 200 000
<b>Temperatureinsatzbereich [°C]</b>	-60 – +200
<b>Wärmeleitfähigkeit [W/mK]</b>	2.0